证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2025-015

南京晶升装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币4,932.77万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币/万元

项目	金额
募集资金总额	112,491.64
减：直接使用募集资金支付的发行费用	10,389.70
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额	471.54
减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额	13,321.74
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	4,071.16
减：闲置募集资金进行现金管理余额	50,000.00
减：银行手续费	0.06
减：永久补充流动资金	32,000.00
加：利息收入	338.41
加：闲置募集资金现金管理收益	2,356.92
截至2024年12月31日募集资金余额	4,932.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023年4月10日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月29日，为配合公司经营管理需要，提高募集资金的管理效率，公司召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”对应的募集资金专用账户进行变更。晶升半导体已于2024年2月2日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户，并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，原募集资金专用账户已注销，其募集资金四方监管协议相应终止。

上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户人	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	2,527.95	存续
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	102.72	存续
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501014302164110	219.62	存续
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	-	已注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	2,075.88	存续
晶升半导体	招商银行股份有限公司南京栖霞支行	125914172310603	-	已注销
合计	4,926.17			

2、截至2024年12月31日，募集资金理财专户存款余额情况如下：

单位：人民币/万元

开户人	开户银行	银行账号	余额	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169220000003315	-	已注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000003316	6.60	存续
合计	6.60			

注1：上述账户为公司及其子公司晶升半导体在南京银行股份有限公司南京紫东支行开立的募集资金理财专户，上述账户仅用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。具体情况详见公司2023年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2023-051）。

注2：晶升半导体于南京银行股份有限公司南京紫东支行开立的募集资金理财专户（账号：0169200000003316）已于2025年1月17日注销完毕。具体内容详见公司2025年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-001）。

注3：期末专户余额未包含持有未到期理财产品金额50,000.00万元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年5月15日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

2024年4月29日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理余额为人民币50,000.00万元，具体明细如下：

单位：人民币/万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024.01.19-2025.01.17	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024.03.15-2025.03.10	否
南京银行股份有限公司珠江支行	结构性存款	保本浮动收益	23,000.00	2024.05.13-2025.05.07	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2024.05.13-2025.02.10	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2024.09.03-2025.01.06	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2024.11.08-2025.11.03	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024.11.29-2025.06.03	否
南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2024.12.20-2025.12.15	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年7月11日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于2024年7月31日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.62%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募投项目尚未完全实施完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投资金投资项目变更实施地点的情况

为持续推进相关募投项目建设进度，保障募投项目顺利实施，同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划，公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点变更。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。

（九）募集资金使用的其他情况

1、使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募集资金投资项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”总投入募集资金金额的情况下，公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币20,255.00万元划转至该募集资金投资项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司晶升半导体的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起，至募集资金投资项目实施完成之日止，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）。

2、使用自筹资金支付募集资金投资项目款项后续以募集资金等额置换

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更，项目和投资用途未变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，晶升股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶升股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券认为：截至2024年12月31日，晶升股份募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2024年度）

单位：人民币/万元

募集资金总额					101,630.39		本年度投入募集资金总额						25,305.80	
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额						49,392.90	
变更用途的募集资金总额比例					不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末项目进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
总部生产及研发中心建设项目	无	27,365.39	27,365.39	27,365.39	8,436.14	16,523.24	-10,842.15	60.38	2025年3月	不适用	不适用	否		
半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	无	20,255.00	20,255.00	20,255.00	869.66	869.66	-19,385.34	4.29	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	/	47,620.39	47,620.39	47,620.39	9,305.80	17,392.90	-30,227.49	36.52	/	/	/	/		
超募资金	无	54,010.00	54,010.00	不适用	16,000.00	32,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	/	101,630.39	101,630.39	/	25,305.80	49,392.90	/	/	/	/	/	/		
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）		由于《南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议》无法按预期计划实施，若继续推进将耗费更多的时间及延长募投项目的建设周期，故为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，同时结合公司产能和研发的需求，拟对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”进行延期及变更。于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》，对该项目的实施地点及实施方式进行变更，并将该项目的预定建设完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。 为持续推进相关募投项目建设进度，保障募投项目顺利实施，同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划，公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，对该项目的实施地点进行变更。 公司已与南京经济技术开发区管理委员会签署《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书》以及《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书补充协议》。截至本报告披露日，上述项目已完成土地出让手续。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用												
对闲置募集资金进行现金管理的情况		详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。												
募集资金结余的金额及形成原因		不适用												
募集资金使用的其他情况		详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况(九)募集资金使用的其他情况”。												

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺的计算口径、计算方法一致。因项目为有效扩大现有的生产能力，且截至报告期末尚未投产，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

注5：公司于2025年3月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部生产及研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

注6：受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响，公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。

证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2025-018

南京晶升装备股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）母公司报表中期末未分配利润为110,269,417.54元。经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本138,366,096股，扣除回购专用证券账户的股份数1,306,117股后的股本数为137,059,979股，以此计算合计拟派发现金红利人民币34,264,994.75元（含税），占公司2024年年度归属于上市公司股东的净利润63.75%。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	34,264,994.75	62,059,762.60
回购注销总额（元）	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,747,098.58	71,017,511.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	110,269,417.54	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	96,324,757.35	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00	
最近三个会计年度平均净利润（元）	62,382,305.28	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	96,324,757.35	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否	
现金分红比例（%）	154.41	
现金分红比例（E）是否低于30%	否	
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	82,262,135.46	
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否	
最近三个会计年度累计营业收入（元）	830,537,068.18	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	9.90	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否	
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

注：公司于2023年4月24日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开了第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。

公司2024年年度利润分配预案符合《南京晶升装备股份有限公司章程》及上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素，充分体现了与全体股东共享公司发展成果的原则。该预案不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2025-022

南京晶升装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。本次部分募投项目延期事项不属于募投项目的变更。

本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投入总额	募集资金计划投入额	实施主体
1	总部生产及研发中心建设项目	27,365.39	27,365.39	晶升股份
2	半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	20,255.00	20,255.00	晶升半导体
合计		47,620.39	47,620.39	-

注：1、公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-042）。

2、公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。

3、公司于2025年3月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

三、本次部分募集资金投资项目延期的相关情况

（一）本次延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际投资情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	2025年12月31日	2027年12月31日

（二）本次延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目的相关实施工作。因受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响，“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的整体实施进度与原预期计划存在差异。

为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合市场需求变化，经审慎评估和综合考虑，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，公司计划将上述募投项目达到预定可使用状态时间的日期调整延长至2027年12月31日。

四、相关募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，具体分析如下：

（一）项目建设的必要性分析

1、半导体行业发展空间巨大，国内产业链自主可控需求提升

凭借巨大的市场需求、稳定的经济增长及有利的扶持政策等众多优势条件，我国半导体产业规模持续快速发展。然而半导体产业国产化进程仍滞后于国内快速增长的市场需求，行业进口替代空间巨大。与此同时，随着国际贸易纷争不断，基于电子信息安全等因素考虑，国内半导体产业链技术水平也亟需发展和提升，行业正处于产业升级的关键阶段。在新兴应用领域的崛起和技术创新的推动下，国内半导体技术自主可控的进程正在加速，半导体材料及设备国产化趋势日趋明显。公司需在快速变革中把握技术趋势，构建差异化优势以应对日益复杂的竞争格局，迎接更广阔的发展空间。

2、增强产品研发及生产实力，助力公司实现战略发展目标

公司长期聚焦于半导体领域，在半导体晶体生长设备领域持续深耕。结合下游产业市场需求，公司根据不同发展阶段产业化应用方向，持续开展不同晶体生长设备的产品开发、产品优化、产品迭代等技术研发，提升产品竞争优势。同时，为进一步延伸半导体产业链产品布局，除主要产品半导体晶体生长设备以外，公司也将加大对于CVD设备、切割设备、减薄设备、抛光设备等其他新产品的研发投入，并积极推进特殊材料、辅材、耗材等材料领域业务。

“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”建成后将为公司产品研发和研发成果大规模量产奠定基础，助力公司深入拓展半导体行业上下游产业链，搭建多元化的业务与产品体系，促进企业高质量纵深发展。

（二）项目建设的可行性分析

1、丰富的技术积累和行业经验形成竞争优势

公司基于在晶体生长设备行业多年积累的专业技术及工艺，通过持续研发，对工艺技术和设备不断优化升级，同时对标国外晶体生长设备前沿技术的发展方向，在晶体生长设备设计、晶体生长工艺及控制等技术方面，形成了独创性的设计及技术，掌握了晶体生长设备设计及控制技术、热场的设计与模拟技术和半导体晶体生长工艺开发技术等核心技术，并成功应用到公司主要产品中且实现量产销售，产品技术水平国内领先，部分技术指标已达到国际主流先进水平。公司凭借自主研发的晶体生长设备技术，以及多应用领域产品技术开发经验，已在半导体级晶体生长设备领域形成丰富产品序列，可满足不同客户差异化、定制化的晶体生长制造工艺需求。公司持续对晶体生长设备进行研发，积累了大量的研发经验和技术储备，有助于公司进一步提升技术水平优势。

2、良好的研发实力推进高质量科技创新

公司积极开展自主研发及创新，不断保持高比例资金的研发投入并高度重视技术研发团队建设和培养。公司持续引进行业内的专业人才，经过多年的积累，已形成了一支经验较为丰富，技术水平较高的技术研发团队，能紧密跟踪国内外先进技术发展趋势，保证了公司能够不断推出新产品，并不断改进现有产品，巩固和提升公司的技术研发能力。公司按照不同研发项目产品，组成了分工明确的专业研发团队，在半导体设备领域不断突破。此外，公司聚焦国际半导体技术前沿，加大了与海外先进技术交流合作的深度与广度。通过和高水平国际人才技术合作，公司能够更敏锐地捕捉全球行业发展动态，更及时地发现最新技术突破，瞄准相关重点领域关键核心技术开展科研攻关，共同推动高质量科技创新。

3、优质的客户资源保障业务持续发展

公司凭借多年的研发及工艺积累，结合“晶体生长设备—工艺技术—晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，形成了自主研发的核心技术，并覆盖了硅片厂商及碳化硅衬底的国内龙头企业或主流客户，与沪硅产业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）、神工股份、合晶科技、三安光电、东尼电子、比亚迪等知名企业建立了合作关系。公司已得到客户的认可并获得客户的重复和批量订单，结合客户产线建设及业务开展情况，持续推进批量销售且保持跟进，形成了较强的客户资源优势。此外，通过与上述半导体制造企业建立合作关系后，对客户的核心需求、技术发展的趋势等方面理解更为深刻，有助于公司在研发方向的选择及增强客户粘性，保证了公司未来收入的持续、稳定增长及业务的进一步拓展。

五、本次延期的影响

公司本次针对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”延期调整是基于客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及该募投项目建设进度的变化，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

六、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（二）专项意见说明

1、监事会意见

公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的相关事项。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。保荐机构对晶升股份本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2025-024

南京晶升装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况